

Market News

TO-220 FullPAK Wide Creepage-Gehäuse macht Behelfslösungen überflüssig

München, 26. April 2016 – Die Infineon Technologies AG bringt das neue TO-220 FullPAK Wide Creepage-Gehäuse auf den Markt. In Kombination mit dem 600 V CoolMOS™ CE entsteht damit eine optimale Lösung für eine große Bandbreite an Low-Power-Anwendungen im Consumer-Bereich. Das neue Gehäuse ist gekennzeichnet durch eine längere Kriechstrecke, die insbesondere für offene Netzteile wichtig ist. Denn hier können Verunreinigungen zu Kurzschlüssen und damit zu Ausfällen der Geräte führen.

Das TO-220 FullPAK Wide Creepage ersetzt häufig genutzte Behelfslösungen, mit denen die Kriechstrecke isoliert werden soll. Beispiele hierfür sind Silikonverguss, Schläuche, größerer Biegeradius der Anschlüsse und andere. Dank der besseren Lösung von Infineon profitieren Kunden von reduzierten Systemkosten.

Größerer Pin-Abstand verhindert Ausfälle

Das neue Gehäuse TO-220 FullPAK Wide Creepage zielt auf offene Netzteile, wie sie etwa in Fernsehgeräten eingesetzt werden. Durch die Luftschlitze, die zur Kühlung notwendig sind, dringen Staubpartikel ein. Mit der Zeit kann dieser Staub die effektive Kriechstrecke zwischen den Kontakten verkürzen, was schlimmstenfalls zu einem Kurzschluss führt. Das neue Gehäuse bietet deshalb einen vergrößerten Kontaktabstand von 4,25 mm. Zum Vergleich: In einem Standardgehäuse TO-220 FullPAK beträgt dieser üblicherweise nur 2,54 mm.

Alle anderen äußeren Maße der beiden Gehäusetyper sind nahezu identisch. Wie ein Standard FullPAK, verfügt auch das neue TO-220 FullPAK Wide Creepage über die mit diesem Gehäusetyper verbundenen Vorteile. Sie zeichnen sich aus durch eine exzellente Isolationseigenschaft und ermöglichen automatisierte Fertigungsprozesse.

Verfügbarkeit

Der Baustein TO-220 FullPAK Wide Creepage steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/TO220-FP-widecreepage.